

ゴミ処理機(テスト機)にて基盤スクラップの処理を行う



テスト製品群



テスト処理時間	:	合計4時間
開始 ~ 250度		30分
250度 ~ 350度		30分
350度 ~ 650度		1時間半
650度 ~ 800度		30分
冷却		1時間

テスト結果)

- ・ 基盤処理のテスト結果は、樹脂は全て溶けて油化となりました。基盤は樹脂とFRPが貼り合わせてあるようで、全てが上手く処理出来ていた。
基盤に装着している部品は、今回のテスト機の温度帯では、解けるまでに達していない為、全体的に焦げている



処理終了後の状態



付着している炭を振るい落とした状態(簡単に取れた。)



油化された水(水は循環して使用)

報告書)

- ・ 上記の結果で述べた様に、テスト機では温度帯が金属を溶かす所(1, 200度以上)まで上がらなかった(800度ぐらい)であった為、基盤の樹脂をカーボン化する所までしか行きませんでした。
また、基盤を重ねてテストを行ったため、きれいに金属とカーボンが分離していなかった。しかし、処理後の基盤は手で簡単にカーボンが剥がれ、銅の配線などを取り除く事が出来た。
- ・ 次回のテストでは、もう少し処理時間(800度)を1時間ほど行い、重なった部分まで処理が出来るかを確認したい。